



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 20726—2006/ISO 15632:2002

## 半导体探测器 X 射线能谱仪通则

**Instrumental specification for energy dispersive X-ray spectrometers with semiconductor detectors**

(ISO 15632:2002, Microbeam analysis—Instrumental specification for energy dispersive X-ray spectrometers with semiconductor detectors, IDT)

2006-12-25 发布

2007-08-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

## 前　　言

本标准等同采用 ISO 15632:2002《半导体探测器 X 射线能谱仪通则》。

本标准的附录 A、附录 B 为规范性附录。

本标准由全国微束分析标准化技术委员会提出。

本标准由全国微束分析标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：中国科学院地质与地球物理研究所。

本标准主要起草人：曾荣树、徐文东、毛骞、马玉光、范光。

## 引　　言

近年来,通过改进探测器的探头晶体和X射线入射窗口新材料的制备工艺以及应用先进的脉冲处理技术,在X射线能谱仪(EDS)技术上取得的进展增强了能谱仪的总体性能,并且将其应用范围扩展到低能量(低于1keV)区域。

过去,能谱仪的特性通常用高能状态下能量的分辨力来表示,定义为Mn-K $\alpha$ 峰半高宽(FWHM)。为了表示在低能量范围的特性,生产厂家给出了C-K,F-K的峰半高宽值或者零峰。一些生产商还规定了峰背比(峰高与本底的比值),即 $^{55}\text{Fe}$ 谱线中的峰与基线的比值或硼(B)的谱线中的峰谷比值。这些量即使相同,它们的定义也可能不同。能谱仪在低能端的灵敏度相对于高能量区而言,明显的依赖于探测晶体和X射线入射窗口的设计。尽管低能端的高灵敏度对于分析轻元素化合物非常重要,但是生产商通常不给出能量与谱仪效率的依赖关系。

在全球范围内要求制定X射线能谱仪(EDS)基本规范的呼声中,本标准应运而生。EDS是分析固体和薄膜化学成分最常用的方法之一。本标准容许在相同规范的基础上,对不同设计的能谱仪性能进行比较,同时根据特殊的要求,帮助找到最合适的能谱仪。另外,本标准也便于对不同实验室的仪器标准与分析结果进行比对。依照ISO/IEC 17025规定,这些实验室应按规定的程序定期检查、校准仪器。本标准可作为所有相关测试实验室制定相似操作程序的指南。

# 半导体探测器 X 射线能谱仪通则

## 1 范围

本标准规定了表征以半导体探测器、前置放大器和信号处理系统为基本构成的 X 射线能谱仪(EDS)特性最重要的量值。本标准仅适用于固态电离作用原理的半导体探测器 EDS。本标准只规定了与电子探针(EPMA)或扫描电镜(SEM)联用的此类 EDS 的最低要求,至于如何实现分析则不在本标准的规定范围之内。

## 2 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

注:除 2.1 外,这些定义都按 ISO 18115 中相同或相似的形式规定。

### 2.1

#### 能谱仪 **energy dispersive spectrometer**

同时记录整个 X 射线谱的谱仪。

注:谱仪包括固态探测器、前置放大器和将 X 射线光子转换为电脉冲的脉冲处理器,其中波高分析被用于给不同能量的 X 射线在脉冲处理器中所形成的脉冲信号分配能量通道。

### 2.2

#### 谱通道 **spectral channel**

所测谱中测量能量的间隔,其宽度由一定的能量增量表示。

### 2.3

#### 仪器检测效率 **instrumental detection efficiency**

检测到的光子量与可用于测量的光子量的比值。

### 2.4

#### 信号强度 **signal intensity**

经脉冲处理后,能谱仪输出的以每通道计数或每通道每秒的计数所表示的量。

### 2.5

#### 峰强度 **peak intensity**

在特定本底上以峰高测量的谱峰信号强度。

### 2.6

#### 峰面积 **peak area**

净峰面积 **net peak area**

在去除本底后,一个谱峰的面积。

### 2.7

#### 背景信号 **background signal**

由于轫致辐射或仪器本底在谱通道中形成的信号。

### 2.8

#### 仪器本底 **instrumental background**

能谱仪的某一部件或多个部件产生的信号,这些信号通常是不希望得到的,它们与样品释放出的信号混合在一起,使测定的谱图产生偏差。